

Title (en)

METHOD AND DEVICE FOR TREATING MATERIAL PLATES

Title (de)

VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM BEHANDELN VON WERKSTOFFPLATTEN

Title (fr)

DISPOSITIF ET PROCÉDÉ D'USINAGE DES PLAQUES DE MATIÈRE

Publication

**EP 3549733 A1 20191009 (DE)**

Application

**EP 19166624 A 20190401**

Priority

DE 102018205073 A 20180404

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum flächigen Behandeln von Werkstoffplatten (10) aus aufgeschäumtem und/oder auch nicht aufgeschäumtem Material, wobei wenigstens eine erste Werkstoffplatte (10) mittels wenigstens einer Fördereinrichtung (40) in einer Transportrichtung (50) wenigstens einer Bearbeitungsstation (102) zugeführt wird. Ein Winkel wird zwischen einem Bearbeitungselement (60) und einer Werkstoffplattenfläche (12) eingestellt, wobei zwischen dem Durchlauf zweier Werkstoffplatten (10) ein Winkel und/oder eine Höhe zwischen einem Bearbeitungselement (60) und einer Werkstoffplattenfläche (12) dynamisch eingestellt werden. Dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Werkstoffplatten (10) aufeinander folgend bearbeitet werden, wobei jede nachfolgende Werkstoffplatte (10) so bearbeitet wird, dass aufeinander folgende Werkstoffplatten (10) im in Transportrichtung (50) zusammengesetzten Zustand an ihrer Grenzfläche kontinuierlich ineinander übergehen.

IPC 8 full level

**B26F 3/00** (2006.01)

CPC (source: EP)

**B26D 5/00** (2013.01); **B26D 5/06** (2013.01); **B26F 3/12** (2013.01); **B26D 5/02** (2013.01)

Citation (search report)

- [XAYI] EP 0399346 A1 19901128 - PHILIPPINE GMBH & CO DAEMMSTOF [DE]
- [A] US 6415570 B1 20020709 - WENTZ JOEL L [US]
- [A] DE 102008051864 A1 20100422 - KLUTH VERTRIEBS GMBH [DE]
- [A] US 4675825 A 19870623 - DEMENTHON DANIEL F [US]
- [Y] DE 19747480 C1 19990429 - YEH TIEN FU [TW]

Cited by

CN113427781A

Designated contracting state (EPC)

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)

BA ME

DOCDB simple family (publication)

**EP 3549733 A1 20191009**; DE 102018205073 A1 20191010

DOCDB simple family (application)

**EP 19166624 A 20190401**; DE 102018205073 A 20180404